

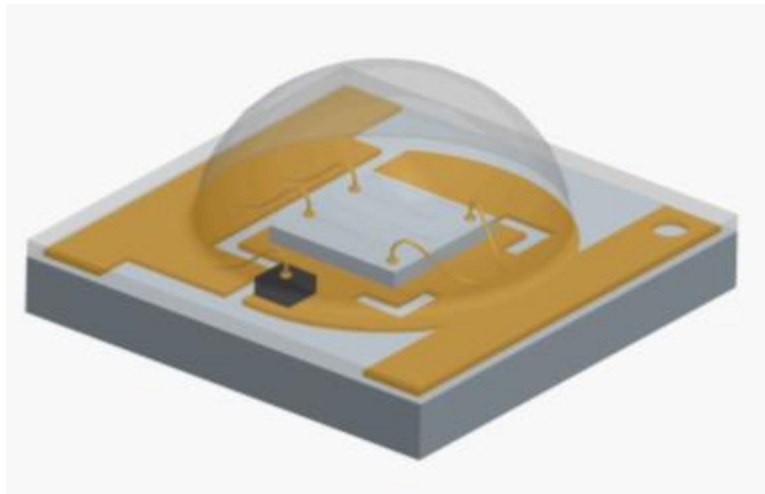


# LED 3535 UV de Potencia

LED SMD 3535 UV de Potencia

Montaje superficial

LED-UV-1W-390-400NM/3535



**Fig. 1.** LED-UV-1W-390-400NM/3535.

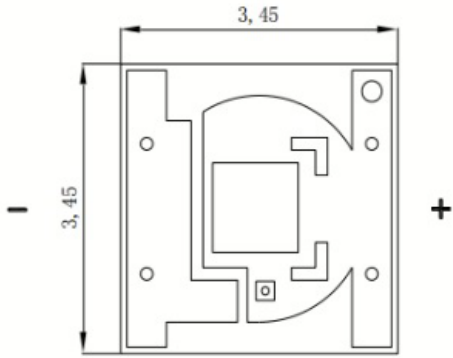
## Parámetros

No. de parte	Potencia (mW)	Corriente nominal (mA)	Voltaje de operación (V)	Flujo radiante (mW)	Longitud de onda (nm)	Ángulo de dispersión (°)
LED-UV-1W-390-400NM/3535	1	350	3.4	410-640	390-400	120

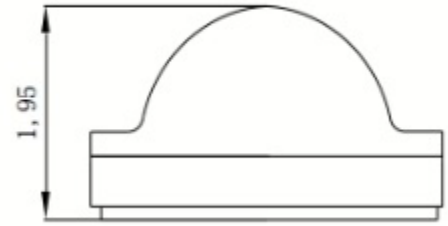




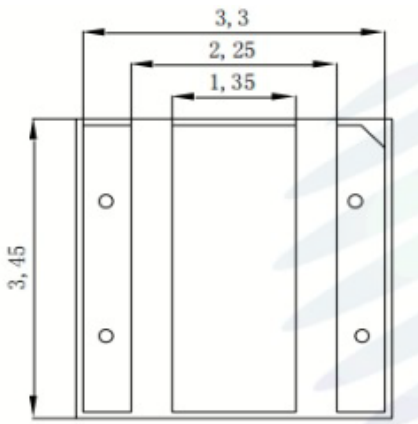
## Dimensiones mecánicas



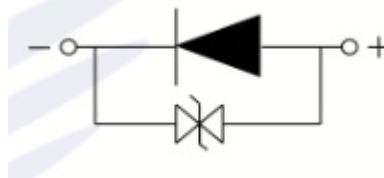
**Fig. 2.** Vista superior.



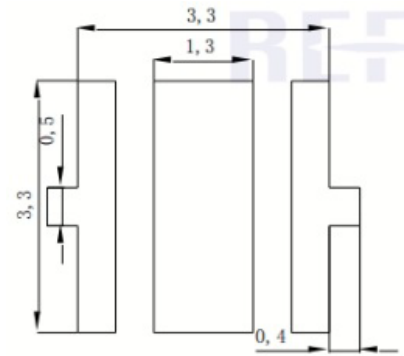
**Fig. 3.** Vista lateral.



**Fig. 4.** Vista inferior



**Fig. 5.** Polaridad



**Fig. 6.** Patrones de soldadura.

Unidades:mm

## Valores absolutos máximos ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Disipación de potencia	$P_d$	1	W
Corriente	$I_F$	350	mA
Corriente de pulso pico	$I_{FP}$	700	mA
Voltaje de reversa	$V_R$	5	V
Rango de temperatura de operación	$T_{OP}$	-40 a 85	$^\circ\text{C}$
Rango de temperatura de almacenamiento	$T_{STG}$	-40 a 100	$^\circ\text{C}$
Temperatura de unión	$T_j$	115	$^\circ\text{C}$
Descarga electrostática	<b>ESD</b>	2000	V

## Características fotométricas ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

Parámetro	Símbolo	Mín.	Tip.	Máx.	Unidad	Condiciones de prueba
Voltaje	$V_F$	3.0	3.4	3.8	V	$I_F=350\text{mA}$
Ángulo de apertura	$2\theta_{1/2}$		120		$^\circ$	$I_F=350\text{mA}$
Flujo radiante	$\Phi_e$	410		640	mW	$I_F=350\text{mA}$
Corriente de reversa	$I_R$			5	$\mu\text{A}$	$V_R=5\text{V}$
Resistencia térmica	$R_{THJ-S}$		6		$^\circ\text{C}/\text{W}$	$I_F=350\text{mA}$



## Condiciones y elementos de prueba

Elementos de prueba	Condiciones de prueba	Tiempo	Cantidad	Ac/Re
Soldadura por refusión	260°C máx 10s	3 veces	10pcs	0/1
Ciclo de temperatura	100°C 30min    5 min -40°C 30min	300 ciclos	10pcs	0/1
Choque térmico	-40°C 30min    10s 100°C 15min	300 ciclos	10pcs	0/1
Temperatura mínima de almacenamiento	-40°C	1000h	10pcs	0/1
Temperatura máxima de almacenamiento	100°C	1000h	10pcs	0/1
Prueba de vida	T <sub>a</sub> =25°C I <sub>F</sub> =350mA	1000h	10pcs	0/1

## Criterio de falla

Elemento	Símbolo	Condiciones de prueba	Criterio de falla	
			Mín.	Máx.
Voltaje	V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> =350mA		U.S.L*)x1.1
Corriente de reversa	I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> =5V		U.S.L*)x2.0
Flujo radiante	Φ <sub>e</sub>	I <sub>F</sub> =350mA	L.S.L*)x0.7	

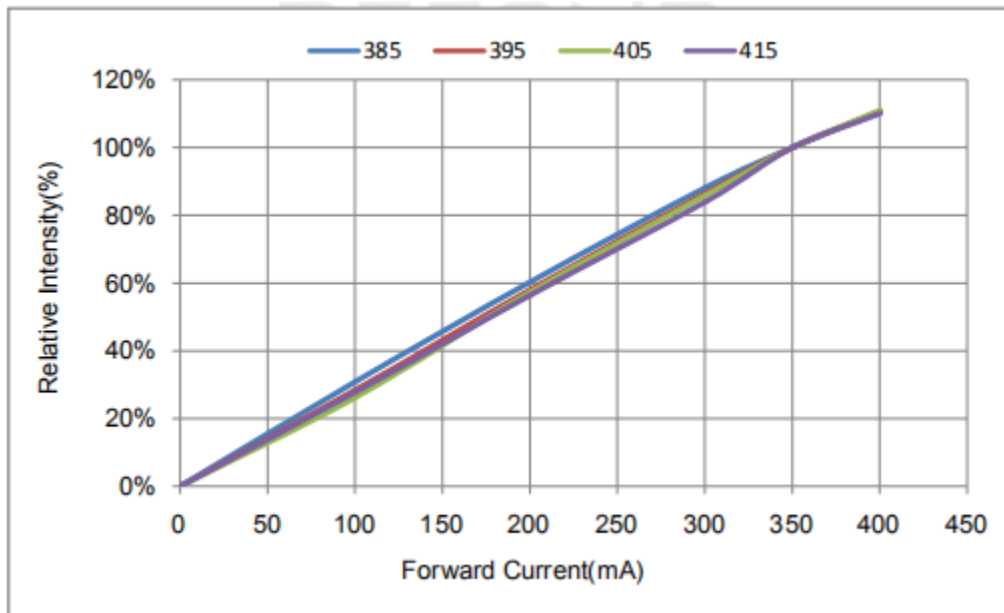
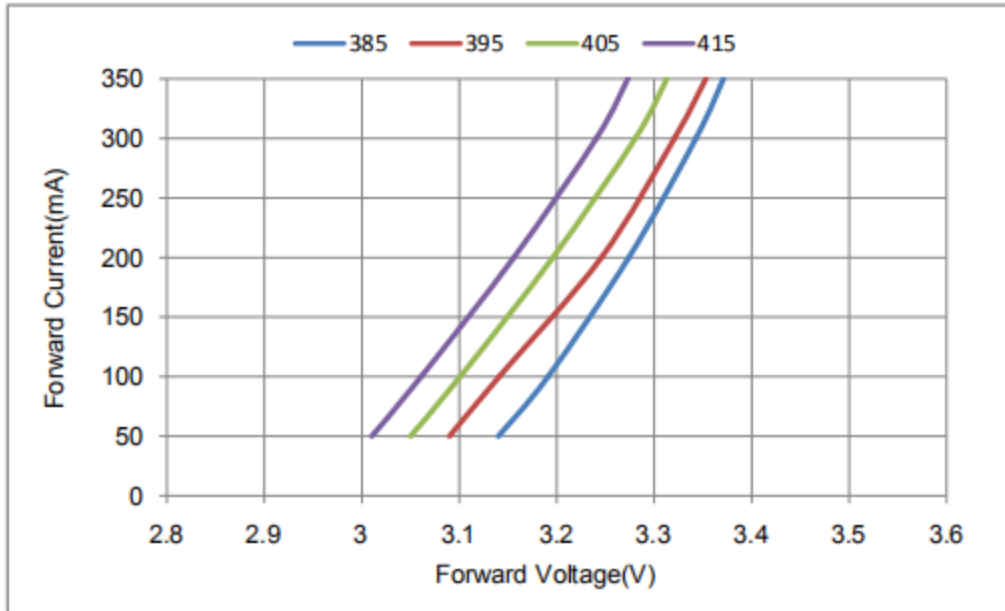
**U.S.L.** Límite de especificación superior

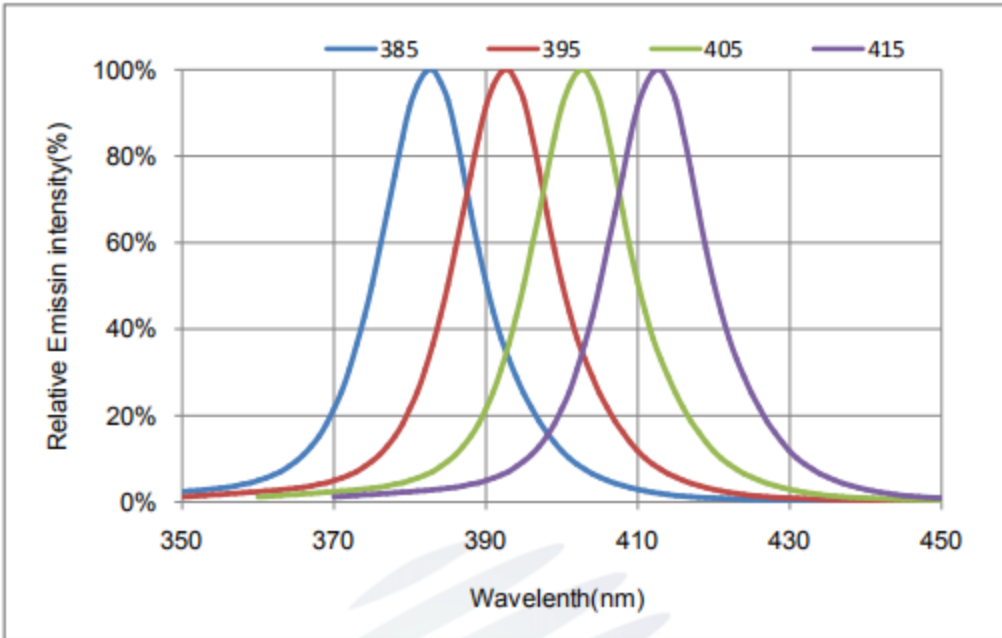
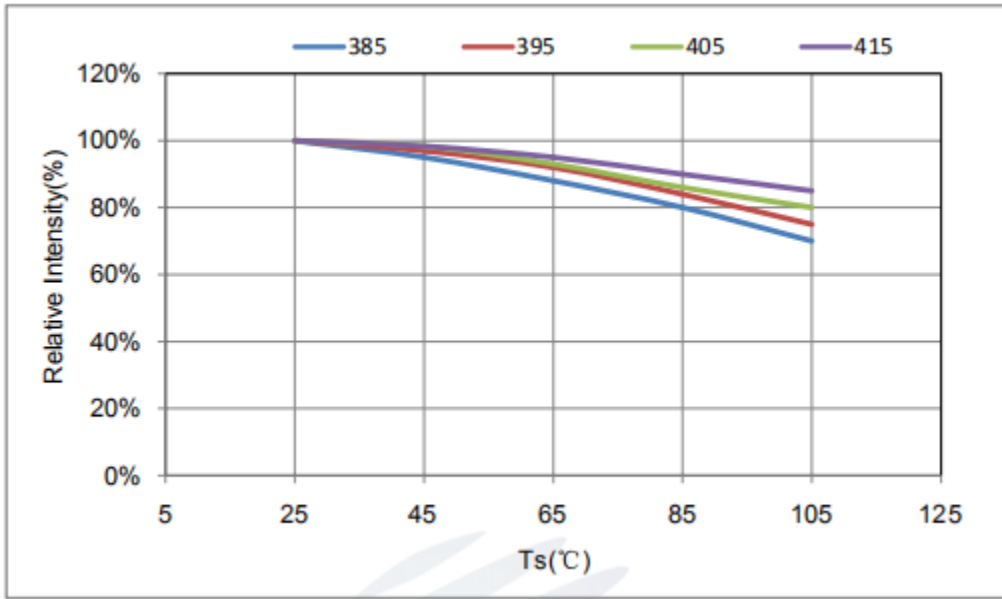
**L.S.L.** Límite de especificación inferior



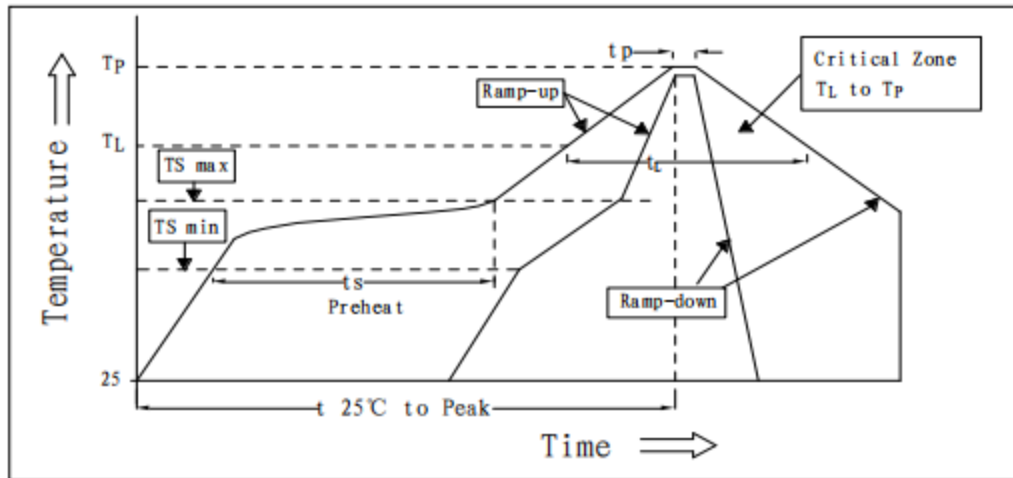


## Curvas características





## Instrucciones para soldadura por refusión



Velocidad de subida de incremento de temperatura promedio (Tsmáx Tp)	3°C/s
Temperatura mínima de precalentamiento (Tsmín)	150°C
Temperatura máxima de precalentamiento (Tsmáx)	200°C
Tiempo de precalentamiento (tsmín tsmáx)	60-120s
Temperatura alta límite (TL)	217°C
Tiempo límite para temperatura alta límite (tL)	60s
Temperatura pico (Tp)	260°C
Tiempo límite para temperatura pico (tp)	10s
Velocidad de enfriamiento	6°C/s



# Empaque

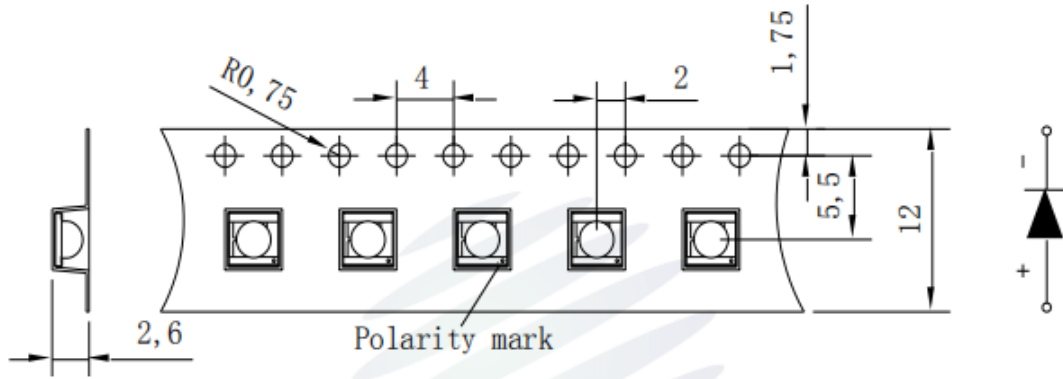


Fig.2-1 Carrier Tape Dimension

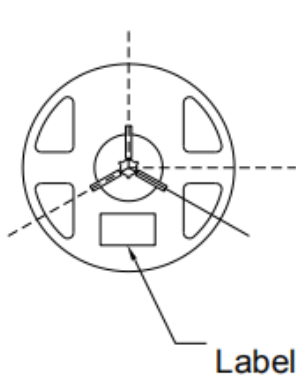


Fig.2-2 Reel Dimension

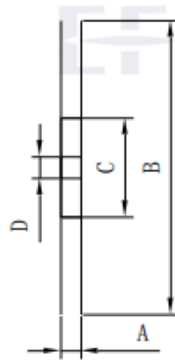


Table 2-1 Reel Dimension

A	12±0.1mm
B	178±1mm
C	60±1mm
D	13.0±0.5mm

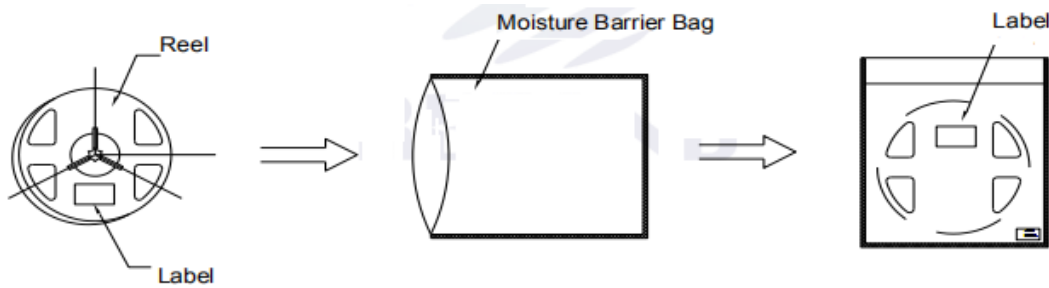


Fig.2-4 Moisture Resistant Packing Process



## Método de operación

